

2023年3月期

決算説明資料

— 業績予想、新中期経営計画 —

2023年5月11日

芝浦メカトロニクス株式会社

目次

1. 2023年3月期 連結決算概要

2. 2024年3月期 連結業績予想

3. 長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」、 新中期経営計画（2023-2025年度）

業績サマリー

■ 通期業績

➤ 過去最高益を更新、半導体前工程が大幅に増加し業績牽引

➤ 前年比 増収増益

売上高 610億円 (1.2倍)、営業利益 109億円 (2.2倍)、
ROS 17.9% (7.6pt増)

半導体前工程の売上増加、顧客評価が完了した貸出評価機などの
売上計上が寄与

➤ 受注高は768億円、半導体前工程が堅調で高水準

➤ 期末配当は過去最高の560円を予定 (前年から330円増配)

業績結果 (対前年)

(単位：億円)

	2021 年度	22/上	22/下	2022 年度	対前年 増減率
売上高	493	293	317	610	+24%
営業利益	50.5	46.0	63.1	109.1	+116%
R O S	10.3%	15.7%	19.9%	17.9%	+7.6pt
経常利益	48.8	42.6	62.6	105.1	+116%
特別損失	6.1	-	-	-	-
当期純利益	29.8	34.1	57.9	92.0	+208%
R O E	12.8%	-	-	31.9%	+19.1pt
受注高	709	474	294	768	+8%
F C F	77.9	43.8	-11.9	32.0	-45.9

* SPE：半導体前・後工程装置

FPD：FPD前・後工程装置

■ 売上高

前年比24%増収 (493億円 ⇒ 610億円)

- SPE分野が増加、FPD分野は減少、全体として増収

■ 営業利益

前年比116%増益 (50.5億円 ⇒ 109.1億円)

- 半導体前工程の売上増加、顧客評価が完了した貸出評価機などの売上計上により増益

■ 当期純利益

前年比208%増益 (29.8億円 ⇒ 92.0億円)

- 営業利益改善、繰延税金資産の追加計上 (9.2億円) により増益

■ 受注高

前年比8%増加 (709億円 ⇒ 768億円)

- 半導体前工程が堅調、半導体後工程・FPD分野は低調だが、全体として増加

セグメント別業績結果 (対前年) ①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

- **売上高** 前年比36%増 (314億円 ⇒ 426億円)
半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやパワーデバイス向け、ウェーハ向けがいずれも順調で増加。
FPD前工程では、前年度受注低調の影響などで減少。
- **セグメント利益** 前年比223%増 (29.8億円 ⇒ 96.3億円)
半導体前工程の売上増加、顧客評価が完了した貸出評価機などの売上計上により大幅増益。
- **受注高** 前年比26%増 (479億円 ⇒ 603億円)
半導体前工程では、全体として堅調に推移。
FPD前工程では、全体として低調に推移。

セグメント別業績結果 (対前年) ②

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- **売上高** 前年比2%増 (138億円 ⇒ 141億円)
半導体後工程では、全体として減少だが、先端パッケージ向けは堅調。
FPD後工程では、TV・モニタ用途の大型パネル向けが堅調で増加。
真空部門では、電子部品向けや半導体向けが堅調で増加。

- **セグメント利益** 前年比17%減 (20.4億円 ⇒ 16.9億円)
半導体後工程の売上減少が影響し減益。

- **受注高** 前年比34%減 (185億円 ⇒ 122億円)
半導体後工程では、一部顧客の投資計画見直しがあり低調に推移。
FPD後工程では、モニタ用パネル向け・車載用パネル向けで受注があったが低調に推移。
真空部門では、電子部品向けや半導体向けが順調に推移。

業績結果 (対前回予想)

*1: 2023年2月公表

(単位: 億円)

	2022年度		
	前回予想 *1	実績	対前回予想 増減率
売上高	590	610	+3%
営業利益	100.0	109.1	+9%
R O S	16.9%	17.9%	+1.0pt
経常利益	96.0	105.1	+10%
当期純利益	75.0	92.0	+23%
R O E	26.8%	31.9%	+5.1pt
受注高	-	768	-

■ 売上高

前回予想比3%増収 (590億円 ⇒ 610億円)

- 半導体前工程が増加し、増収

■ 営業利益

前回予想比9%増益 (100億円 ⇒ 109億円)

- 半導体前工程の売上増加、利益率改善、経費抑制による

■ 当期純利益

前回予想比23%増益 (75億円 ⇒ 92億円)

- 営業利益改善、繰延税金資産の追加計上 (9.2億円) による

配当

当社は、連結配当性向をおおむね30%を目途としています。

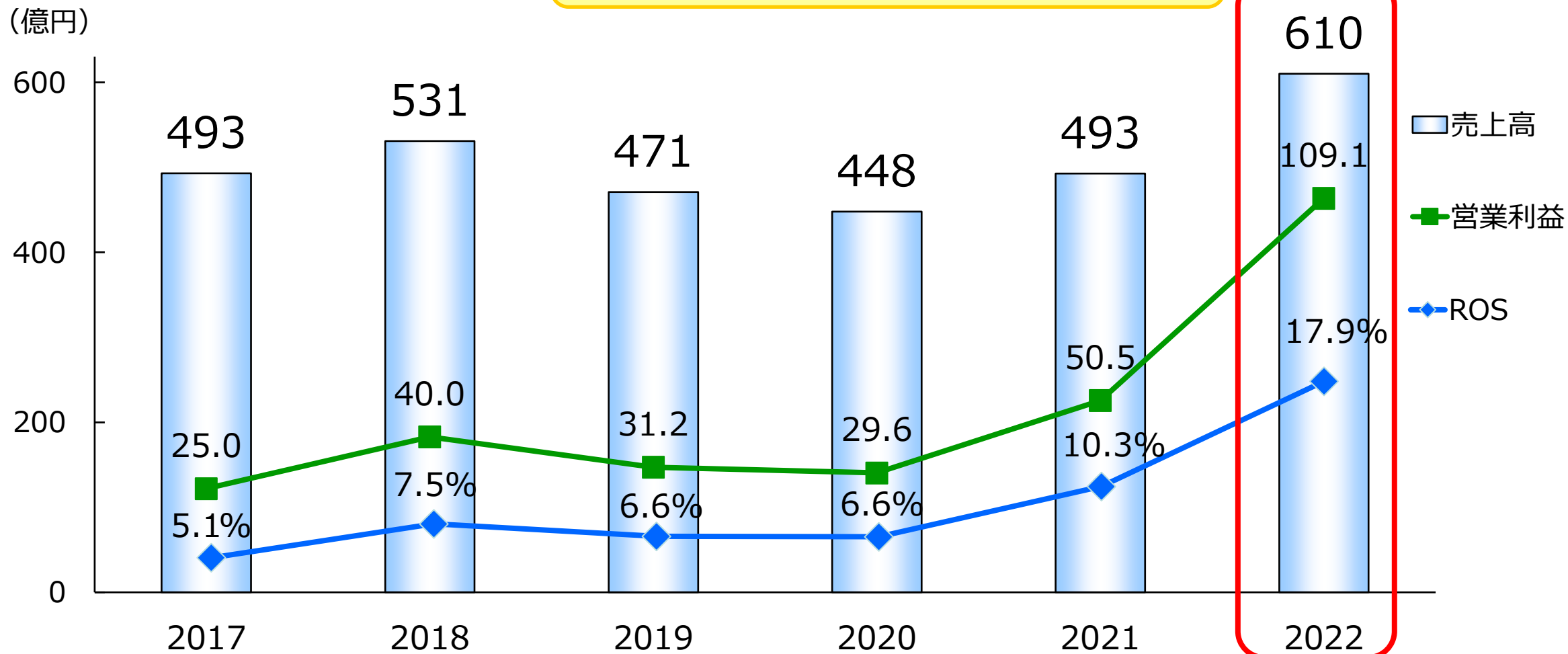
当期純利益が前回予想を上回ったため、期末配当は、前回予想から50円増配の560円を予定しています。(前年から330円増配)

なお、繰延税金資産の追加計上による当期純利益の増加分(9.2億円)を除外した額に対して、配当算定(配当性向29.9%)しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
2023年3月期	0円	560円	560円
2023年3月期 (前回予想)	0円	510円	510円
2022年3月期 (前年)	0円	230円	230円

売上高・利益・ROS

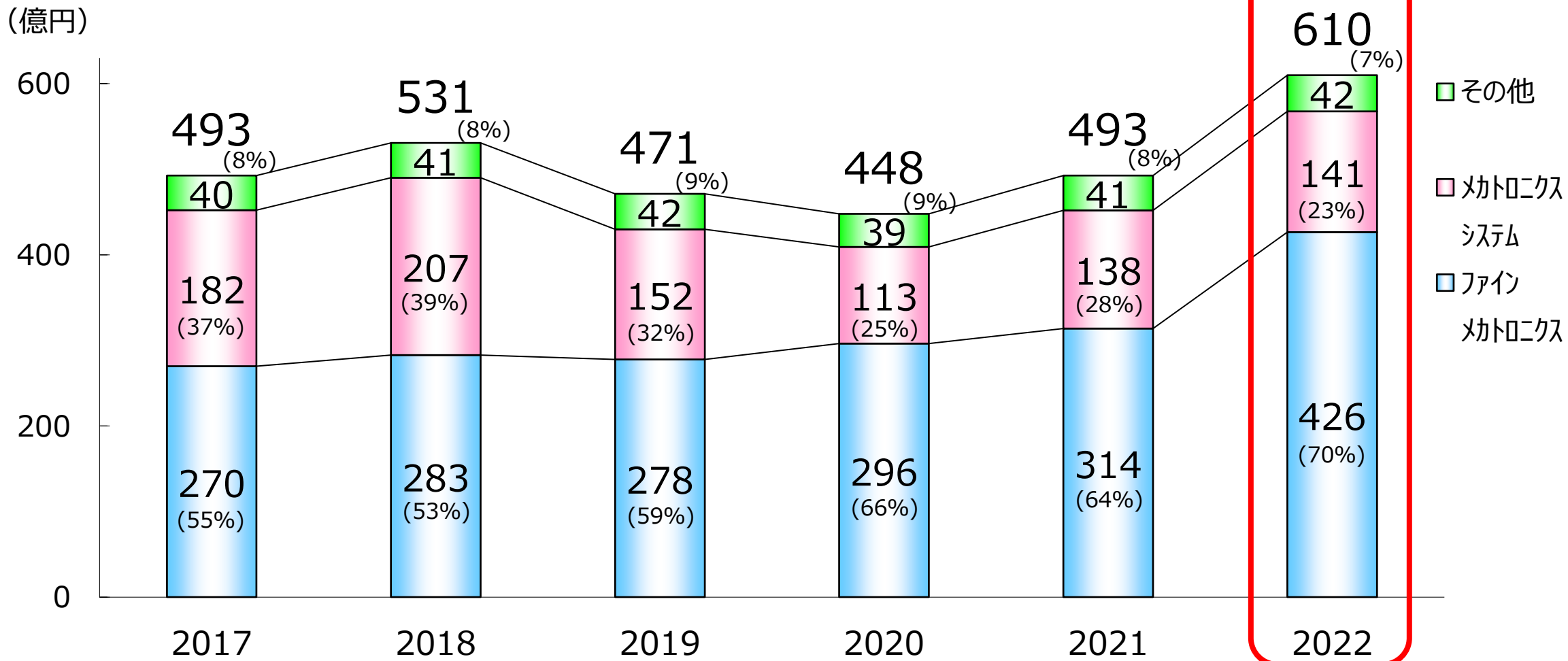
SPE分野が増加、顧客評価が完了した貸出
評価機などの売上計上 ROS17.9%



セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 70%

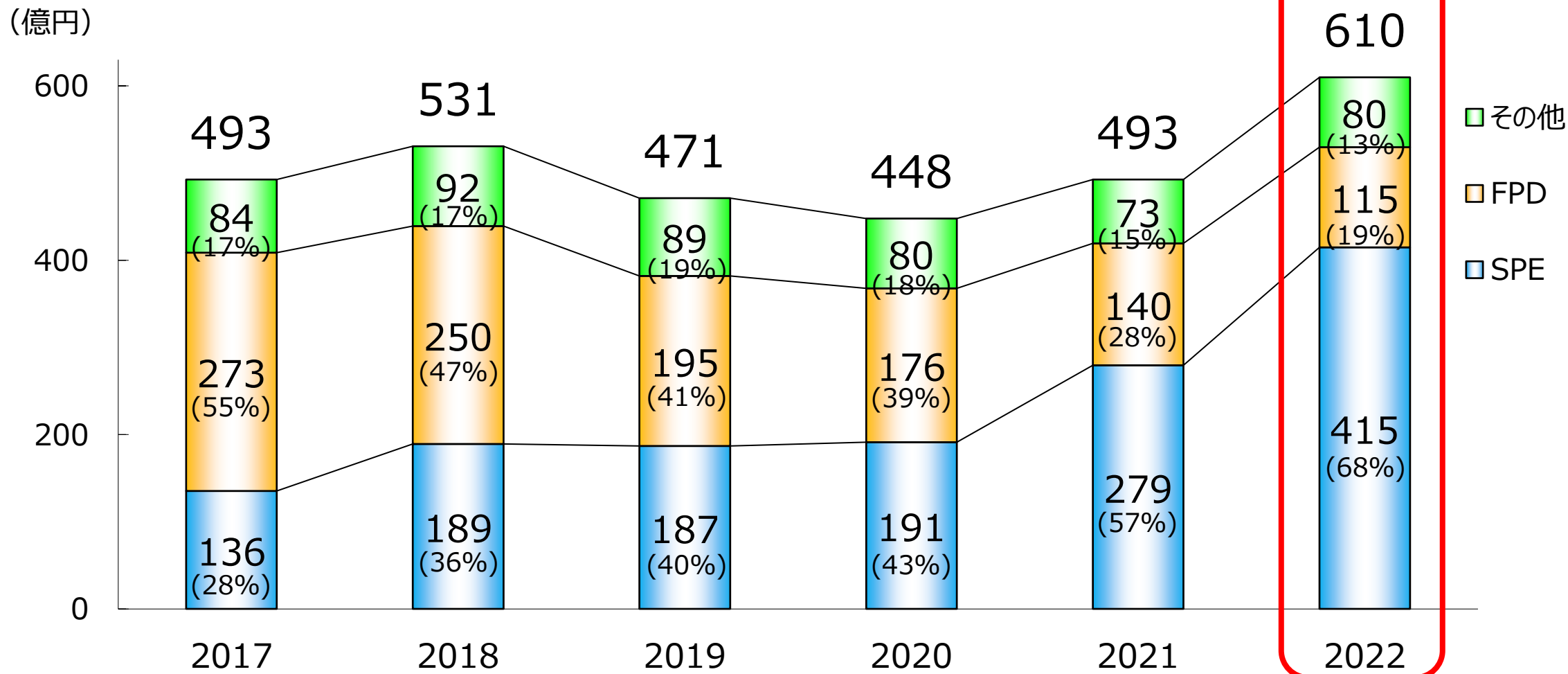
* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別売上高

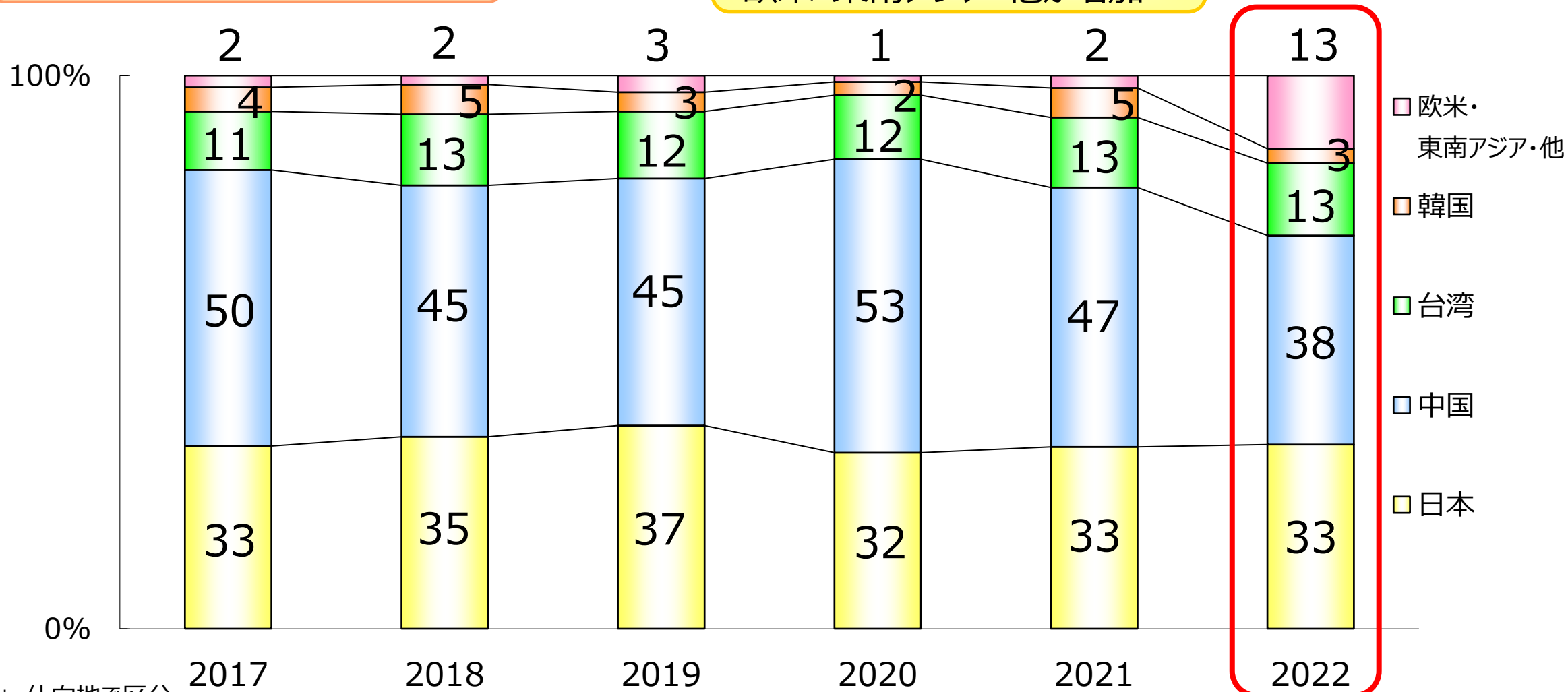
SPE分野が大幅に増加し68%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置



地域別売上高比率

海外向け67% (中国38%)
欧米・東南アジア・他が増加

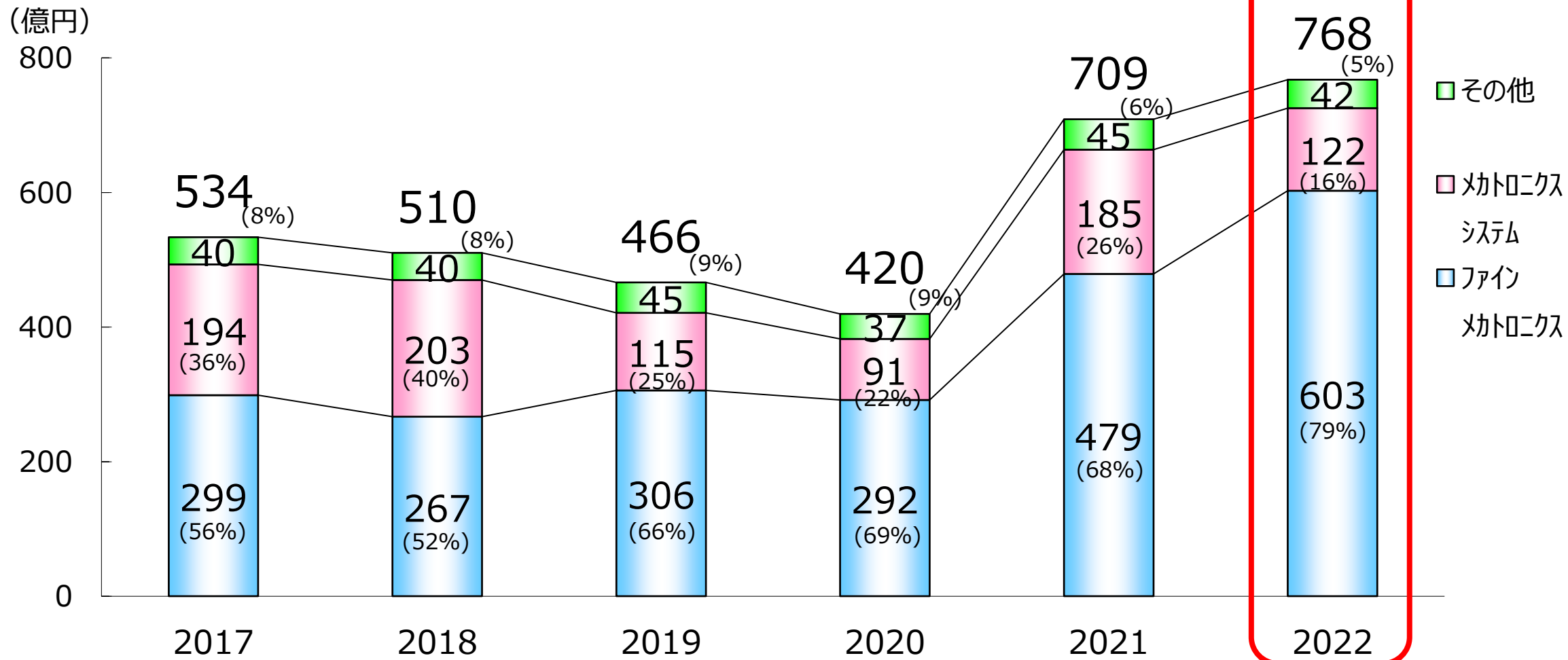


* 仕向地で区分

セグメント別受注高

ファインメカトロニクス 79%

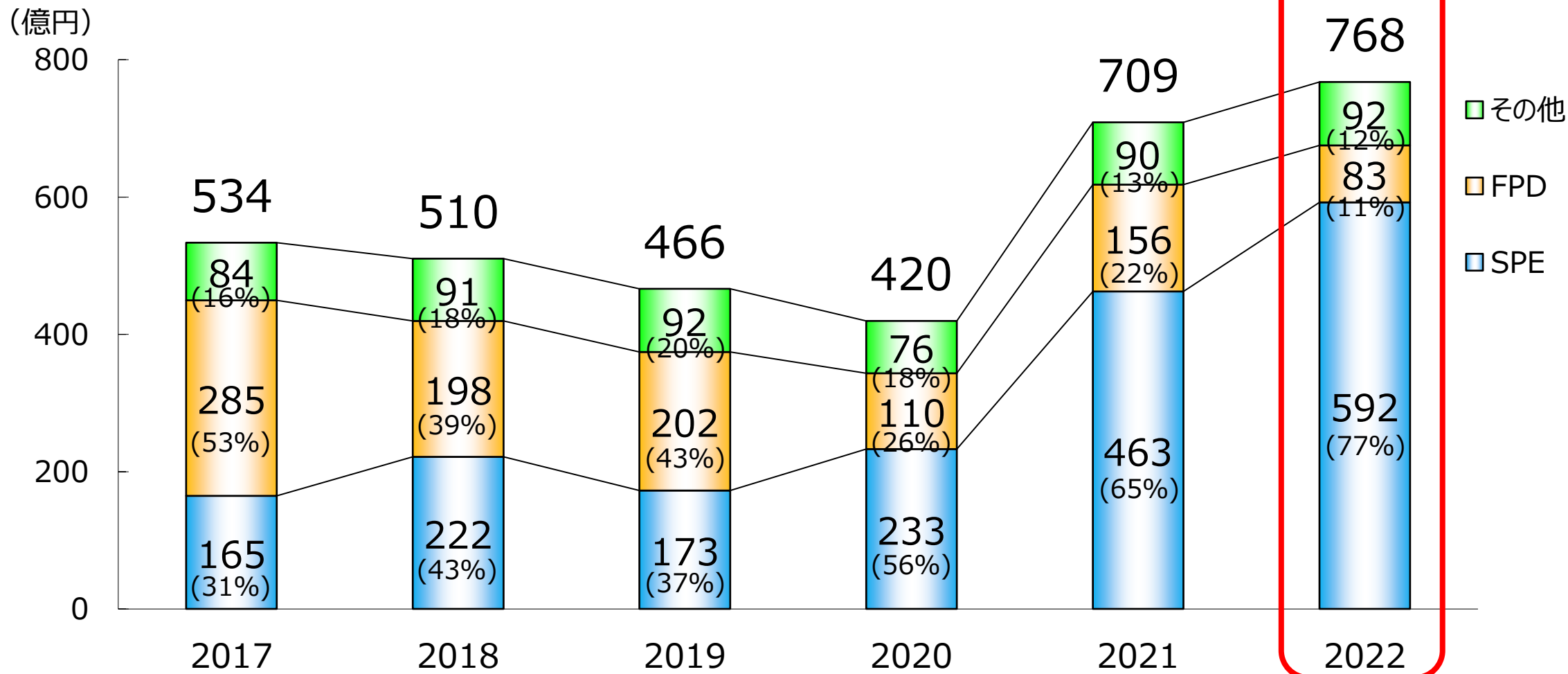
* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別受注高

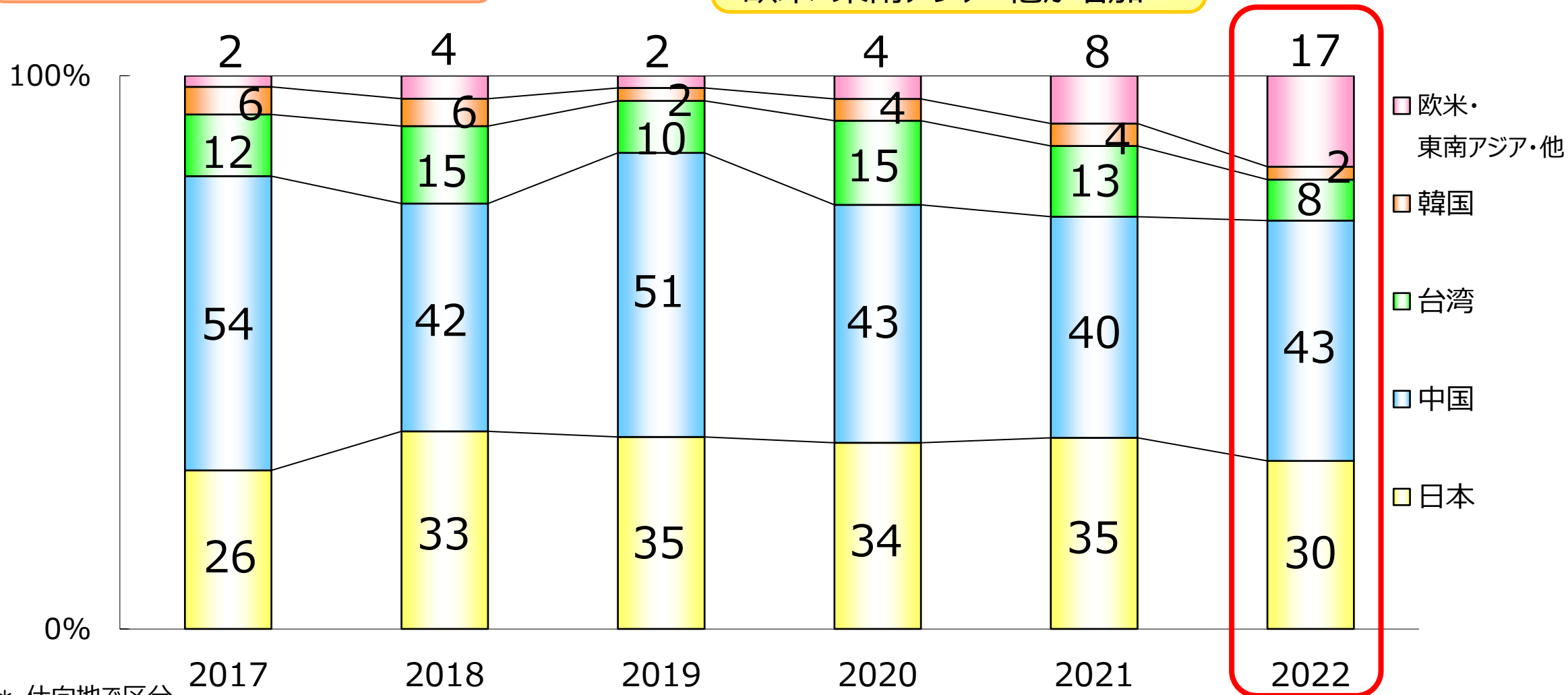
SPE分野が大幅に増加し77%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置



地域別受注高比率

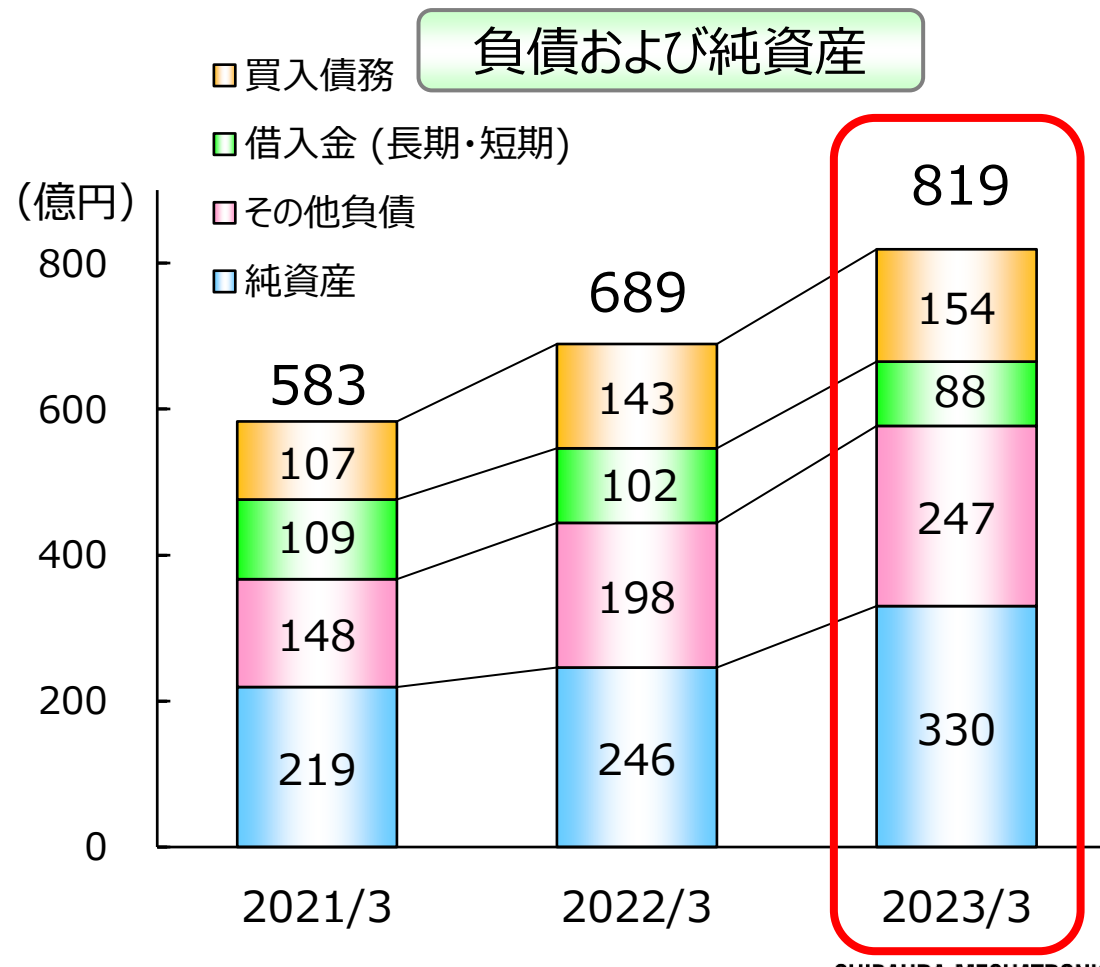
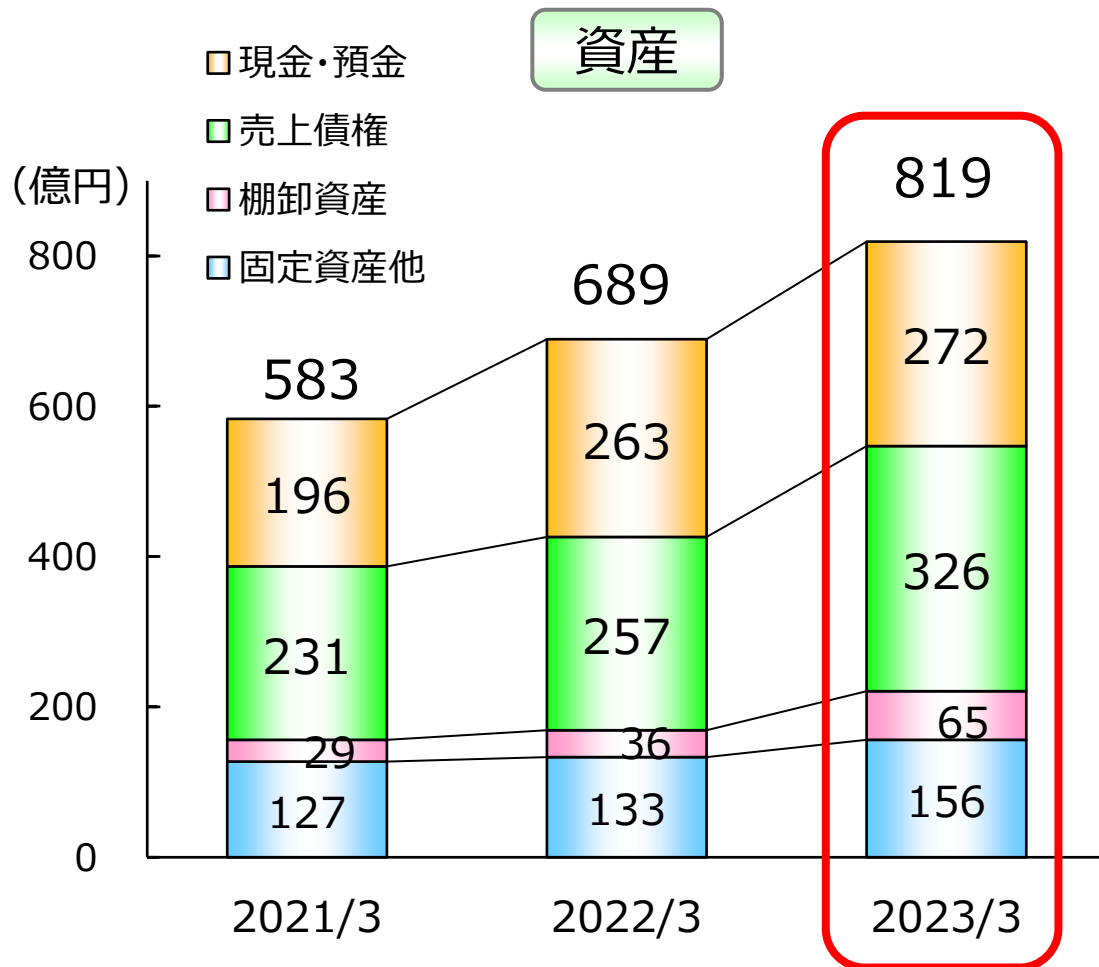
海外向け70% (中国43%)
欧米・東南アジア・他が増加



* 仕向地で区分

貸借対照表

自己資本比率 36% ('22/3) → 40% ('23/3)
 D/Eレシオ 41% ('22/3) → 27% ('23/3)
 ROE 12.8% ('22/3) → 31.9% ('23/3)



目次

1. 2023年3月期 連結決算概要
- 2. 2024年3月期 連結業績予想**
3. 長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」、
新中期経営計画（2023-2025年度）

業績予想サマリー

■ 事業環境

- 当社の事業環境は、半導体業界は短期的には一部投資計画の見直しがあると想定
FPD業界はコロナ禍における強い需要の反動から設備投資が落ち込み、より長期化する様相

■ 通期業績予想

- 過去最高益の2022年度に比べて2023年度は減収減益
売上高590億円（3%減）、営業利益73億円（33%減）
研究開発・開発設備・人財への投資を推進、ROS12.4%に一旦低下
（成長投資費用として対2022年度約30億円増加見込み）

2023年度 業績予想 (2)

業績予想

*23/上、23/下見通しはご参考

(単位：億円)

	2020 年度	2021 年度	2022		2022 年度	2023		2023 年度 予想	対前年 増減率
			22/上	22/下		23/上 見通し	23/下 見通し		
売上高	448	493	293	317	610	260	330	590	-3%
営業利益	29.6	50.5	46.0	63.1	109.1	31.0	42.0	73.0	-33%
R O S	6.6%	10.3%	15.7%	19.9%	17.9%	11.9%	12.7%	12.4%	-5.5pt
経常利益	28.2	48.8	42.6	62.6	105.1	28.0	39.0	67.0	-36%
当期純利益	19.7	29.8	34.1	57.9	92.0	23.0	29.0	52.0	-44%
R O E	9.5%	12.8%	-	-	31.9%	-	-	15.0%	-16.9pt
F C F	74.1	77.9	43.8	-11.9	32.0	-	-	30.0	-2.0

配当予想

当社は、連結配当性向をおおむね30%を目途としています。
 2024年3月期の期末配当は、1株につき3株の割合で株式分割するため、
120円を予定しています。(分割前360円に相当)

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
2024年3月期	0円	※ 120円	※ 120円
2023年3月期	0円	560円	560円
2022年3月期	0円	230円	230円
2021年3月期	0円	110円	110円

※2023年10月1日を効力発生日として1株につき3株の割合で株式分割を実施予定。

株式分割・自己株式の消却

■ 株式分割

株式の分割によって投資単位を引き下げ、投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えることにより、投資家層の拡大を図ることを目的としています。

分割の割合	1株につき3株の割合をもって分割
基準日	2023年 9月30日
効力発生日	2023年10月 1日

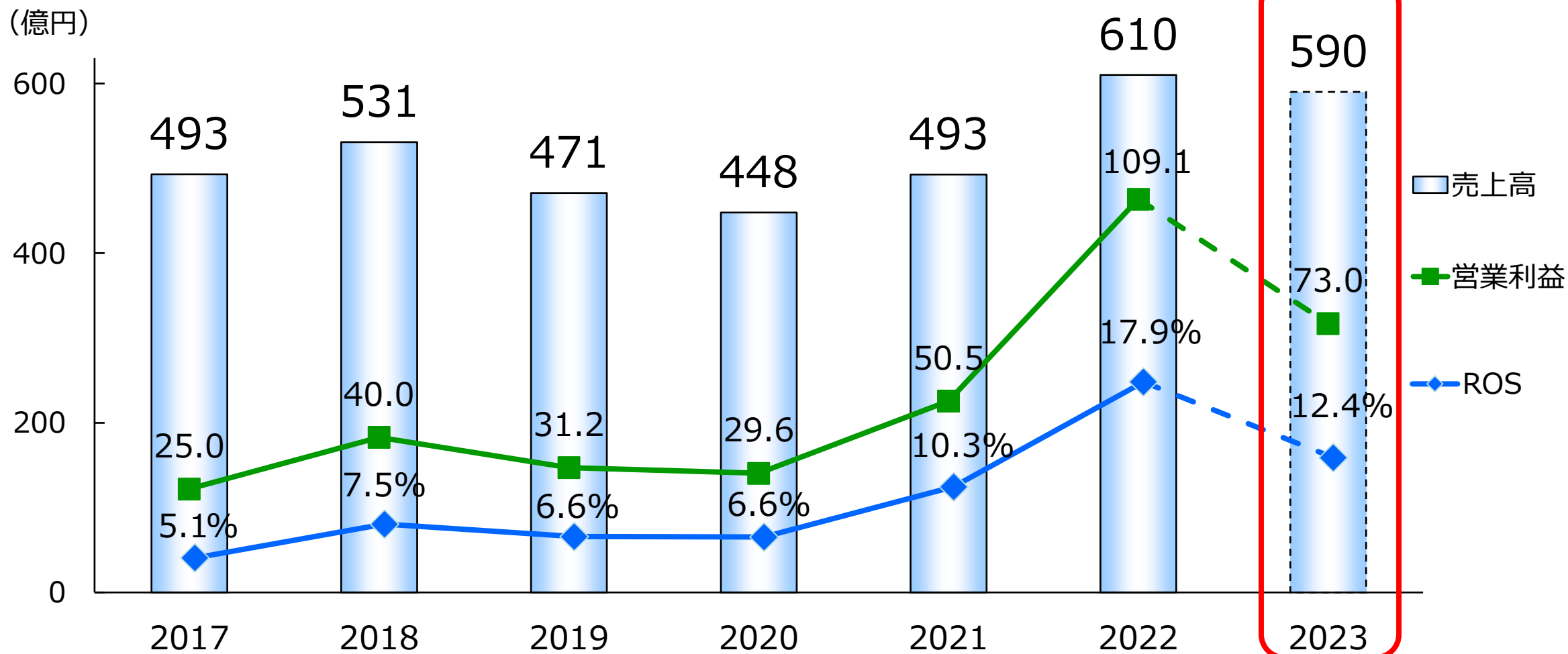
	現在	株式分割後
発行済株式総数	4,657,300株	13,971,900株
発行可能株式総数	10,000,000株	30,000,000株

■ 自己株式の消却

2023年5月31日を消却予定日として、535,319株（消却前の発行済株式総数に対する割合10.3%）を消却します。

※詳細につきましては、本日（2023年5月11日）公表しました「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」および「自己株式の消却に関するお知らせ」をご覧ください。

売上高・利益・ROS

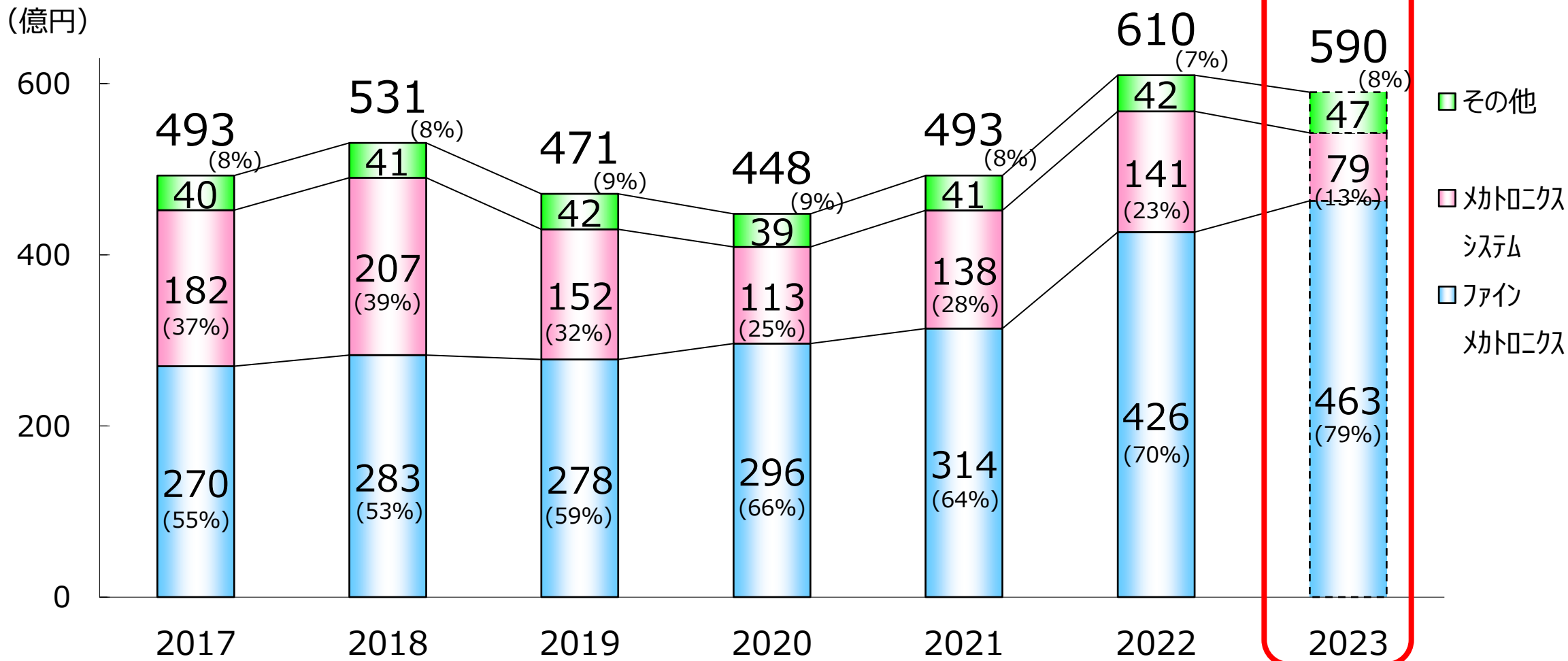


2023年度 業績予想 (6)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 79%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

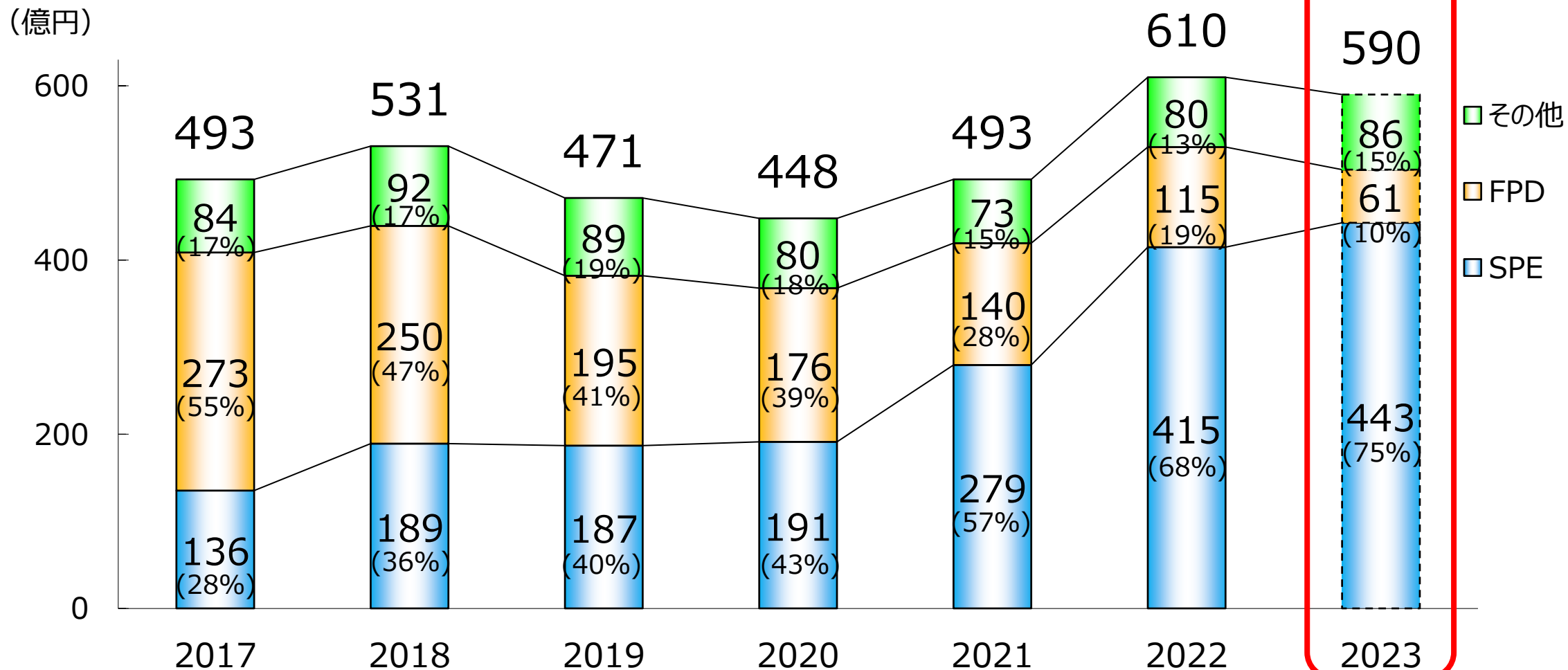


2023年度 業績予想 (7)

分野別売上高

SPE分野75%に拡大

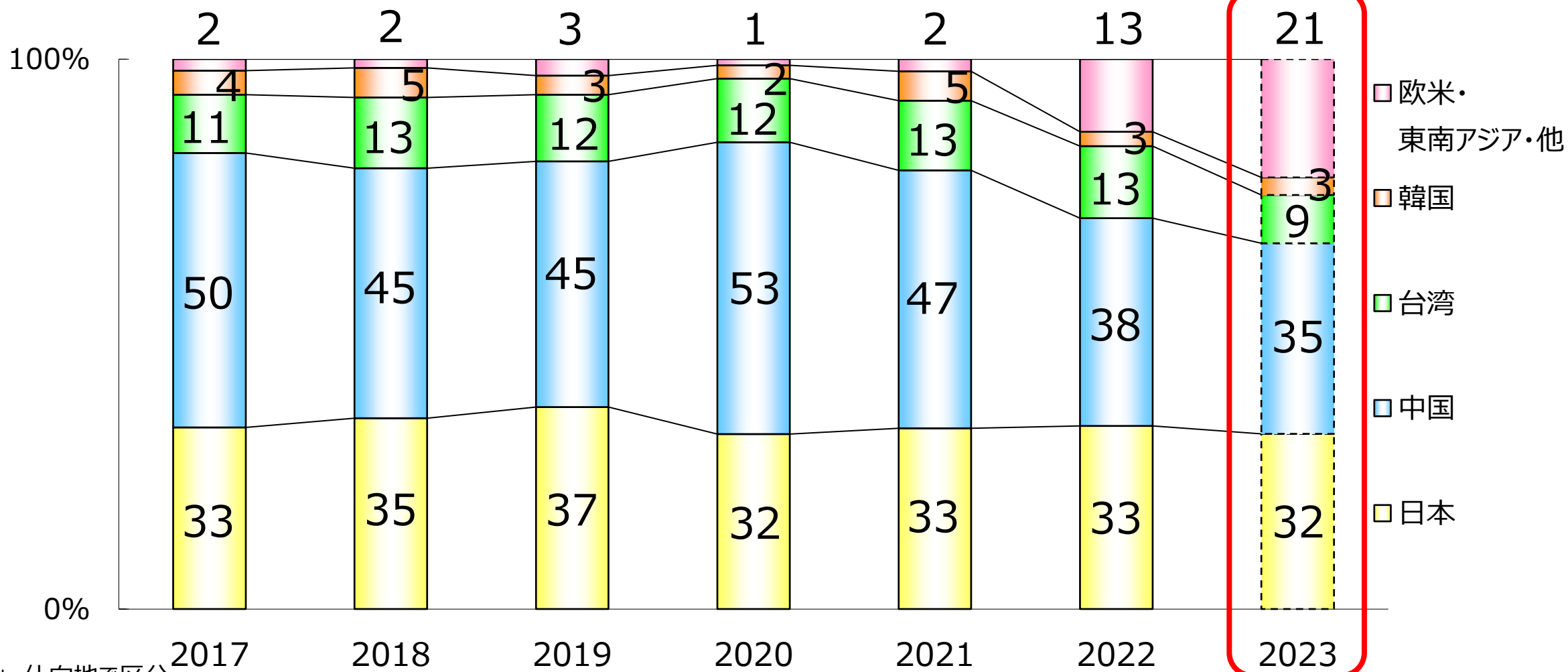
* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置



2023年度 業績予想 (8)

地域別売上高比率

海外向け68% (中国35%)
欧米・東南アジア・他が増加



* 仕向地で区分

目次

1. 2023年3月期 連結決算概要
2. 2024年3月期 連結業績予想
- 3. 長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」、
新中期経営計画（2023-2025年度）**

前中計振り返り (1)

前中計方針

2014-2016

– FPD分野主体 –

2017-2019

– SPE分野成長 –

2020~
これからのありたい姿へ

SPE

FPD

グローバル
ニッチトップ
製品拡大

利益率向上

SPE分野
拡大

これからのありたい姿

- ◆ IoT、5G、AIと、これから更に広がるデータ社会に向けて、半導体・FPD製造装置を通じた先端技術で貢献 ～「ものづくり」から「価値づくり」～
- ◆ SPE分野でグローバルニッチトップ、FPD分野で主要サプライヤとして存在感を示せる企業グループへと成長

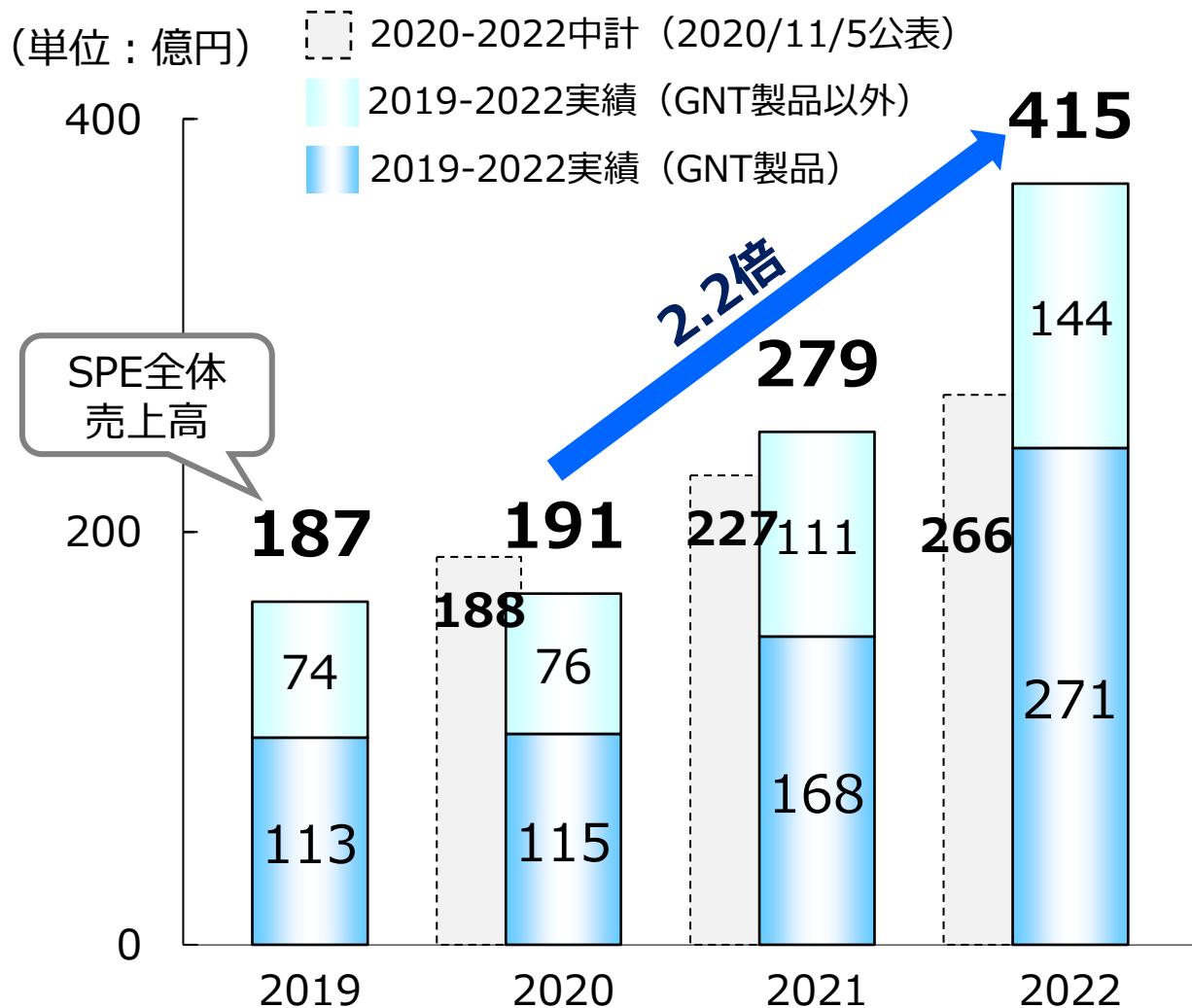
当初目標と実績

3年中計の最終年度は当初目標を大幅に上回り達成

(単位：億円)

	当初目標 (2020年11月公表)			実績			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	対2022 目標
売上高	460	480	510	448	493	610	+19.6%
営業利益	30.0	38.5	51.0	29.6	50.5	109.1	+113.9%
ROS	6.5%	8.0%	10.0%	6.6%	10.3%	17.9%	+7.9Pt
ROE	9.5%	11.5%	13.0%	9.5%	12.8%	31.9%	+18.9Pt

グローバルニッチトップ製品・SPE分野の拡大



2020-2022中計期間 グローバルニッチトップ対象製品群 (GNT製品)

工程	対象装置	主な対象製品等
Siウェーハ製造	枚葉式洗淨装置	300mmウェーハ (プライム、再生)
フォトマスク製造	・エッチング装置 ・枚葉式洗淨装置	ブランクス、PSM、EUVマスク、次世代EUVマスク
ウェーハプロセス	枚葉式リン酸エッチング装置	ロジック/ファウンドリ
モジュールプロセス	高精度フリップチップボンダ	FO-WLP/PLP、2.5D、CoWハイブリッドボンディング

方針・計画と結果

グローバル
ニッチトップ
製品拡大

GNT製品 '22売上高 対'20比		
Siウェーハ製造	44→135億円	(3.1倍)
フォトマスク製造	4→49億円	(12.3倍)
ウェーハプロセス	42→44億円	(1.0倍)
モジュールプロセス	25→43億円	(1.7倍)

SPE分野
拡大

- 前工程：Siウェーハ向け枚葉式洗浄装置が受注・売上を牽引
- 後工程：先端パッケージ向けボンダがロジック向けを中心に伸長

利益率向上

- SPE分野の拡大のほか、各分野での取組みも進め、全体として利益率が大幅向上
- ROS…'20：6.6% ⇨ '22実績：17.9%

研究開発

- 方針どおり主にSPE分野に注力
- 投入金額は3年間合計90億円の全体計画に対し実績82億円

他社との
連携

- SPE分野を中心に、連携アイテム・連携先、連携により売上に寄与した規模がいずれも拡大
 - － 主要アイテム：17件→35件
 - － 対売上高：約12%→約32%

サービス
事業

- 海外売上高比率の高まりに応じ、海外サービス拡大
- '22売上高比率23%とした目標に対しては20%と未達

成果と課題 ➡ 引き続き次の成長に向け、長期視点での取組みを進める

芝浦ビジョン2033

当社として捉える社会変化・課題

市場

- IoT、(Beyond) 5G、AIやAR、VRなどデジタル社会の進展に伴う半導体・FPD等市場の拡大

技術

- 先端性の高い半導体の開発・製造
- 技術者の育成、確保

環境

- カーボンニュートラル、環境負荷への配慮
- 資源の有効利用

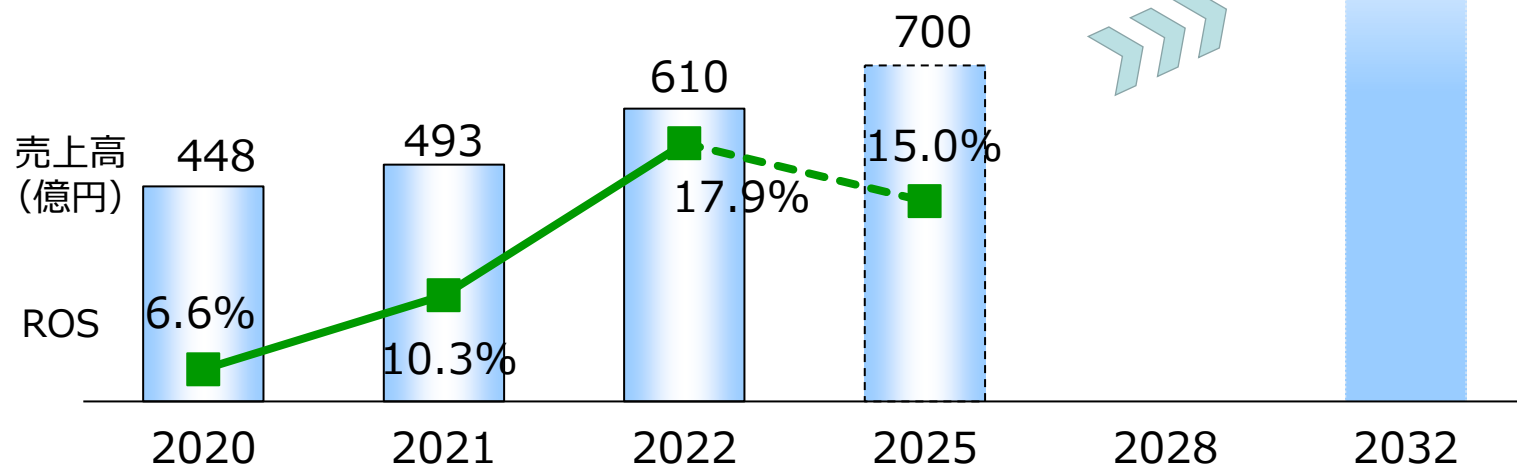
安定供給

- 半導体需要の高まり・確保、供給力不足
- 求められる機能の多様化、高度化
- 地政学的リスクへの懸念

10年後のありたい姿

**社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業**

ビジョン期間内で
 ・売上高1,000億円以上
 ・ROS20%以上
 を目指す



ビジョン達成に向けた重点的取組み

重点的取組み

ポート フォリオ

- SPE：グローバル ニッチトップ製品拡大を核に更なる拡大
- FPD：新型・次世代向け製品を拡大

技術

- 課題・ニーズの把握と、解決に繋がる技術開発、製品・サービスへの展開
- 製品とサービスのより一体的な提案により、全体付加価値向上

人財

- ビジョン達成を担う人財力強化、持続的成長に向けた積極採用
- DX推進を含む業務生産性向上

財務

- 成長性と資本効率の両面を意識した、財務規律の堅持
- 事業成長・株主還元を重視した、キャッシュアロケーションの実現

新中計位置付け

2023.4.1 – 2033.3.31

ビジョン達成

**2023-2025
芝浦ビジョン2033
Phase.1**

2026-2028
芝浦ビジョン2033
Phase.2

2029-2032
芝浦ビジョン2033
Phase.3

「持続的成長に向けた投資」を柱として、
次の成長に向けた土台強化を進め
再び営業利益100億円超を目指す

4
つ
の
柱

- ① SPE分野の更なる拡大
- ② 持続的成長に向けた投資
- ③ 課題とニーズの把握
- ④ マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進

<2025年度目標>

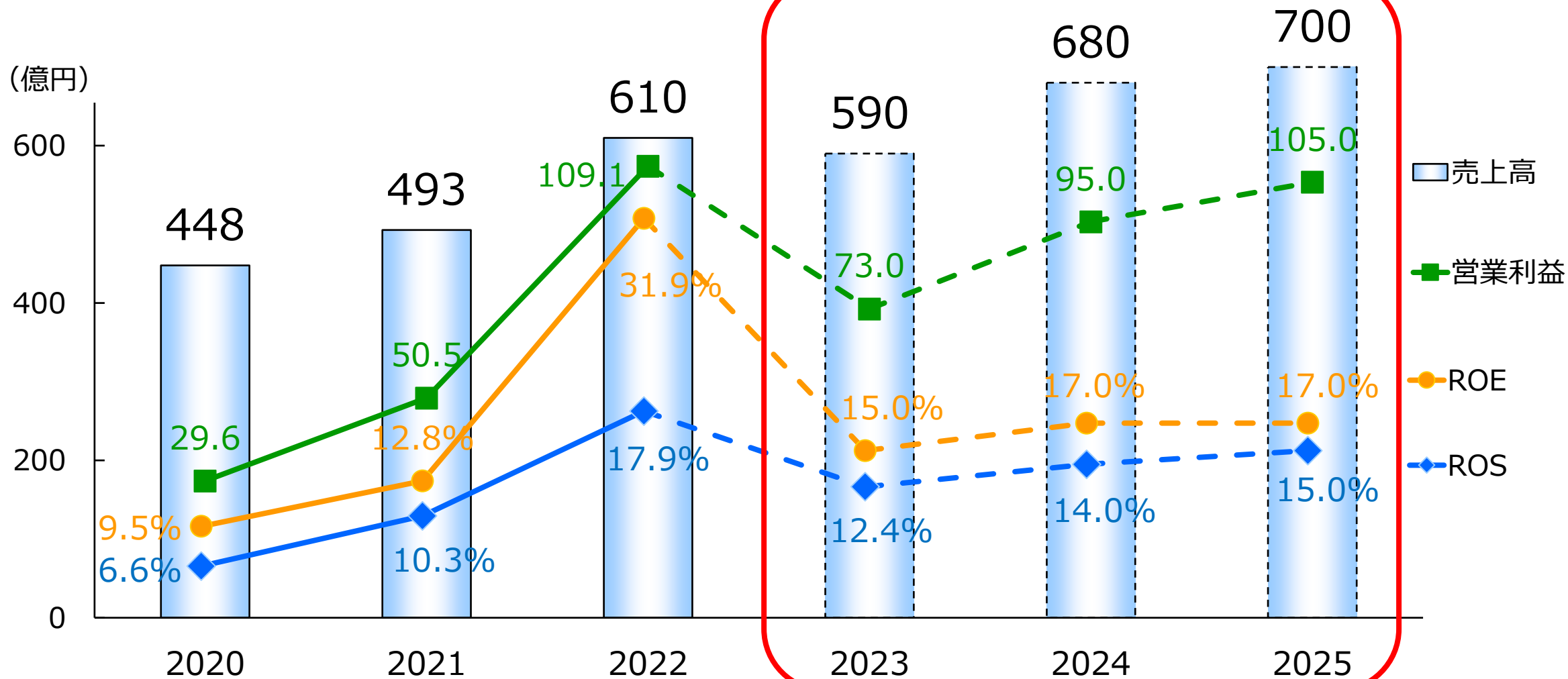
売上高	700億円
営業利益	105億円
ROS	15%
ROE	17%

年度別目標 ①

(単位：億円)

	2022年度 (実績)	2023-2025新中期経営計画 芝浦ビジョン2033 Ph.1 年度別目標		
		2023年度 (業績予想値)	2024年度	2025年度
売上高	610	590	680	700
営業利益	109.1	73.0	95.0	105.0
ROS	17.9%	12.4%	14.0%	15.0%
ROE	31.9%	15.0%	17.0%	17.0%

年度別目標 ②



分野別市況と当社の方向性 ①

*1 出典：TechInsights Manufacturing Analysis Inc. 2023-4

*2 出典：Display Supply Chain Consultants, LLC 2023-4
いずれも暦年、グラフは当社にて作成

S
P
E

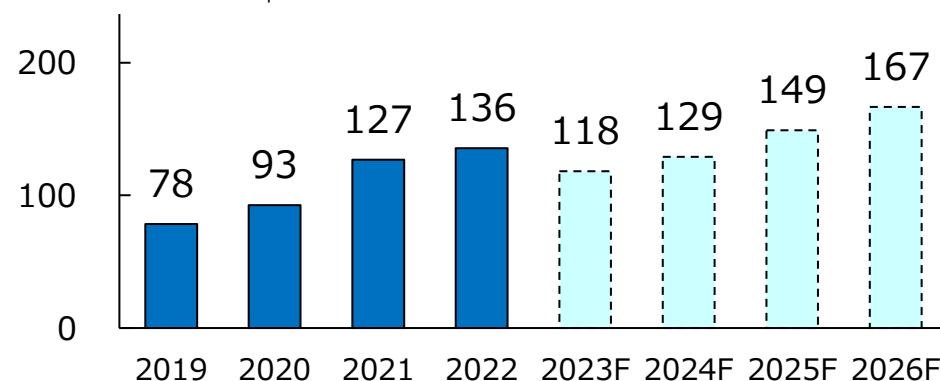
- 社会のデジタル化が進み中長期的に半導体需要旺盛
- 製造装置の需要も牽引される見通し
- 輸出管理強化、部品・部材の調達状況などリスクになり得る事象は継続注視



引き続き実績と強みのある次世代・先端半導体に対応した
装置開発・販売を推進

■半導体製造装置 売上高予測 *1

(単位：10億US \$)



F
P
D

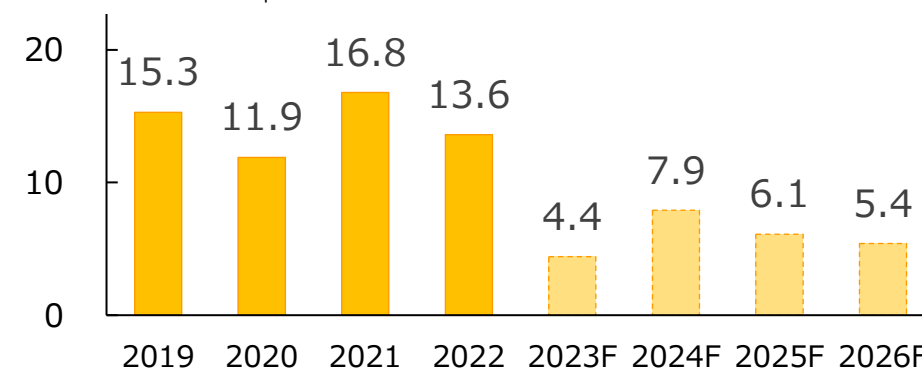
- 社会のデジタル化の中で必須な技術・製品であるFPD
- 設備投資需要は24年度に回復傾向となる予測
- 設備投資需要回復と、新型・次世代ディスプレイ市場の立上り・拡大に期待



主要サプライヤとしてのポジションを堅持し、
新型・次世代向け製品の開発・拡販に注力

■FPD製造装置 売上高予測 *2

(単位：10億US \$)



分野別市況と当社の方向性 ②

真空応用

- これまでもあらゆる産業、分野で用いられてきた真空応用技術の需要は継続
- 今後の社会のデジタル化に伴い、自動車のEV化、通信（5G）、エネルギー関連市場などでの需要拡大に期待



特に電子部品、通信デバイス分野での拡大を目指し国内主要顧客の将来製品への対応や海外顧客への展開などを進めて行く

ヘルスケア

- 現状国内の錠剤識別コードとして主流の刻印方式に対し、今後印刷方式比率の高まりや、印刷方式の中でもスタンプ方式からインクジェット方式へシフトが進む可能性
- 当社コア技術を応用したインクジェット式錠剤印刷装置の需要の高まりに期待



国内におけるシェア拡大を図り、消耗品のリカーリングビジネス拡大へ繋げる
海外市場への展開にも注力

*装置機種は例

4つの柱① : SPE分野の更なる拡大 ①

Siウェーハ製造

フォトマスク製造

モジュールプロセス

枚葉式Siウェーハ
洗浄装置



マスク
エッチング装置



マスク洗浄装置

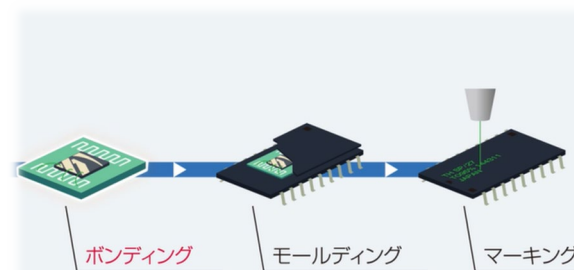
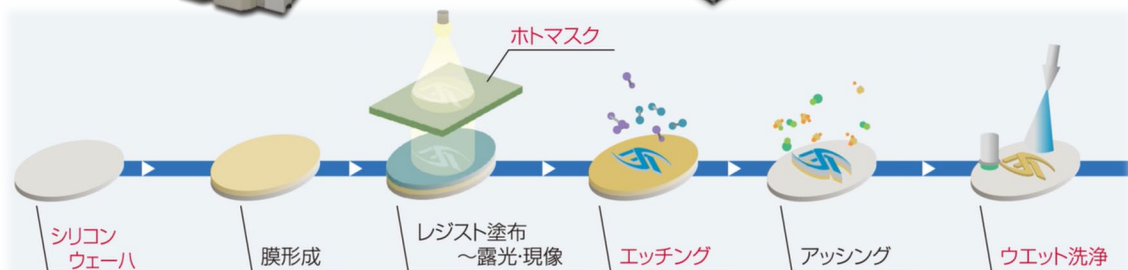


高精度2.5Dボンダ

超高精度ハイブリッドボンダ



高精度Fo-PLPボンダ



その他の注目製品

ウェーハプロセス

新しいGNT製品



ケミカルドライエッチング装置



枚葉式リン酸
エッチング装置

創出・拡大に
注力

- 引き続き4工程の製品群をGNT製品群に位置付け
- GNT製品群を核としたSPE分野の拡大を追求
- 新しいGNT製品を創出

4つの柱① : SPE分野の更なる拡大 ②

- GNT製品として実績の高い既存製品群の多面的(用途、顧客、エリア)拡大で一層のシェアアップ
- 継続的な新機種・新製品開発で、次世代GNT製品拡大の種まき
- 顧客、研究機関など外部との連携をより強化
- 生産増加にフレキシブルに対応可能な人員とエリアを確保

Siウェーハ製造

枚葉式洗浄装置のこれまでの実績を活かし、シェアキープ&アップ

フォトマスク製造

エッチング装置は次世代EUV市場でのシェアアップ、
洗浄装置は凍結洗浄技術搭載の新機種上市でシェアアップを狙う

ウェーハプロセス

枚葉式リン酸エッチング装置の高生産性装置、メモリ向け装置上市予定
実績を活かし更にこの先の課題に対応する開発継続

モジュールプロセス

超高精度ハイブリッドボンダで市場における地位確立を狙う

その他

ケミカルドライエッチング装置は、次世代パワー半導体市場でのシェアアップ
独自技術を搭載した新しいGNT製品の創出に注力

4つの柱②：持続的成長に向けた投資

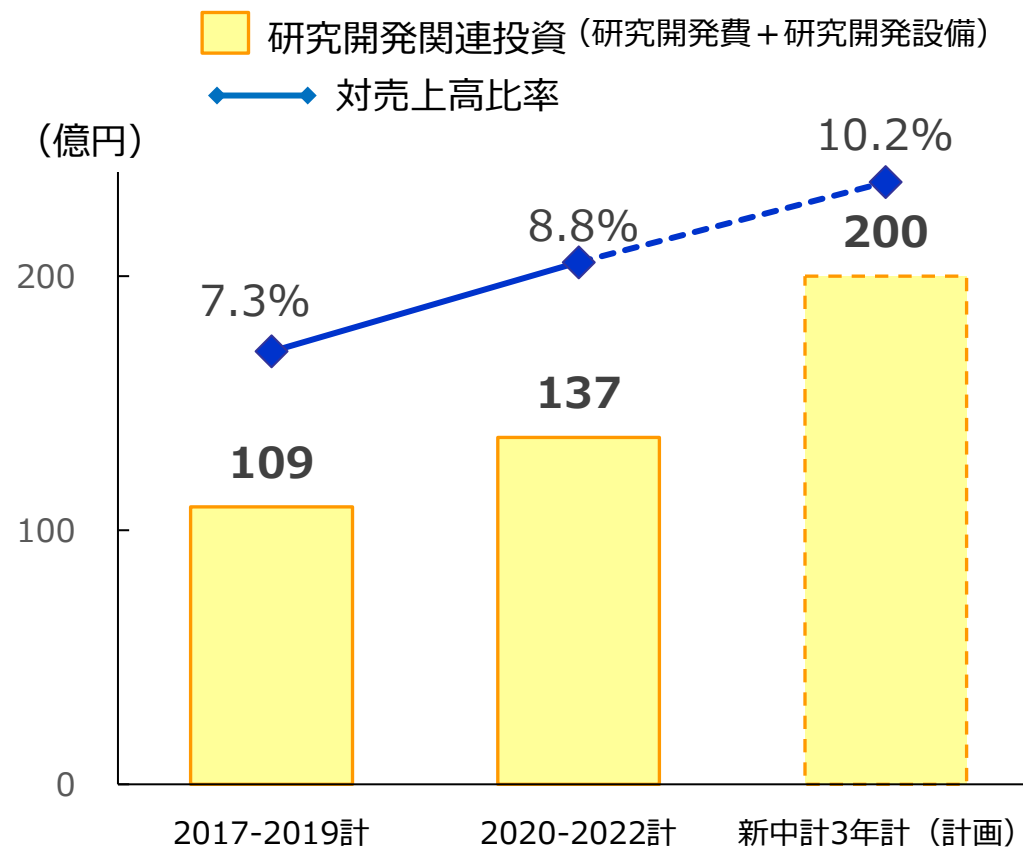
研究 開発 関連

- 研究開発費はSPE分野への投入、注力継続
- より積極的な開発・評価体制の整備に向け、評価設備も強化
- 新中計期間3年間で約200億円の投資を計画

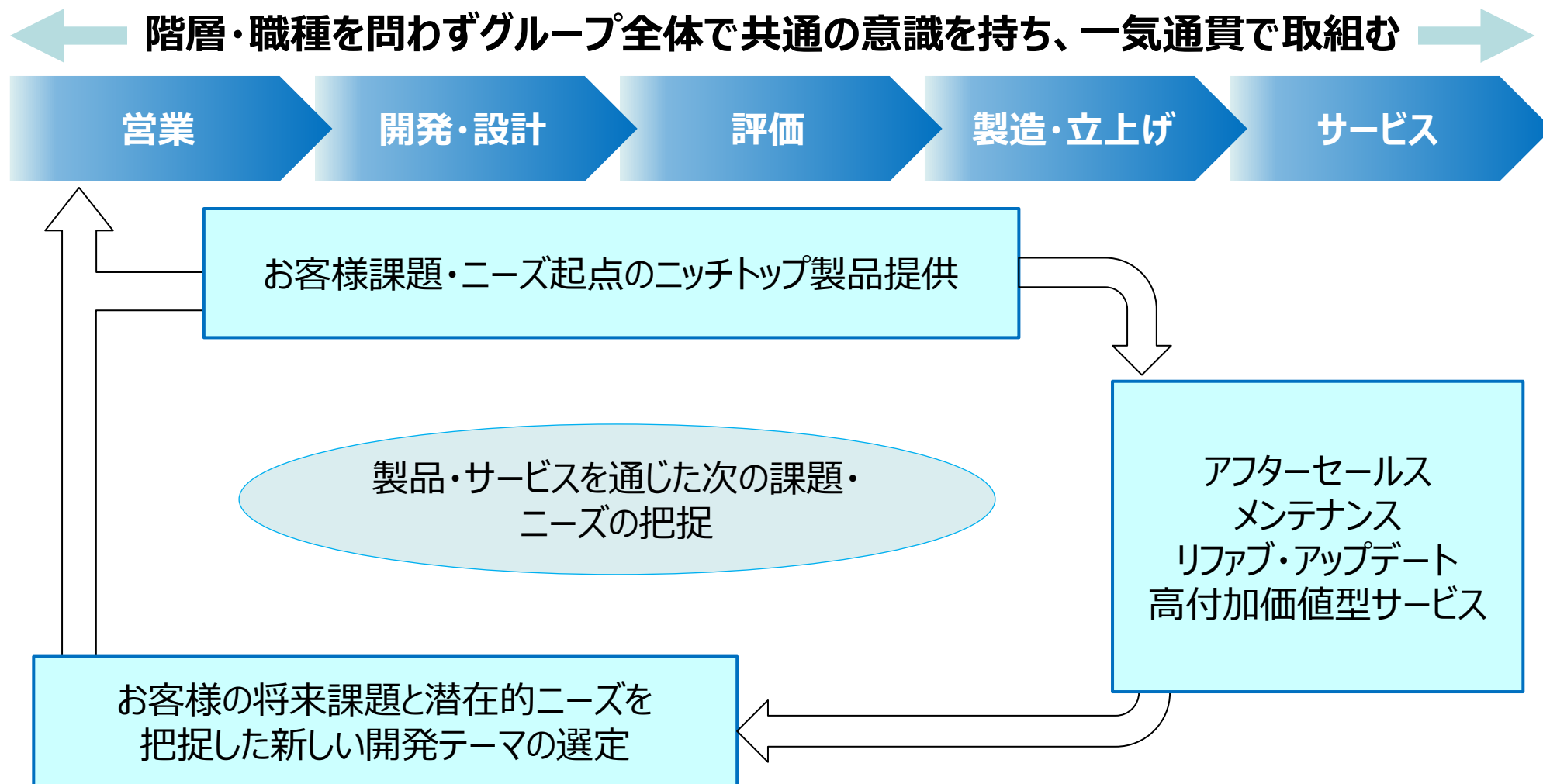
人財

- 長期視点かつ積極的な採用・育成
- より生き生きと働くための制度・環境整備

■ 研究開発関連投資額・売上高比率推移
(3年中計期間合計別)



4つの柱③：課題とニーズの把握



4つの柱④：マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進 ①

事業を通じて展開するマテリアリティ

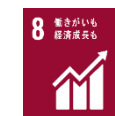
最先端技術の開発・提供で
デジタル社会に貢献

社会変化を見据えた最先端技術の開発・提供により、デジタルを活用したより豊かで創造的な社会を創出



研究開発・製造プロセスで産業
競争力の維持・向上に貢献

ものづくり人財の育成強化や知的財産の創出とマネジメントの深化により、グローバル展開する企業として産業競争力の維持・向上を実現



環境調和型製品の開発・提供で
グリーン社会に貢献

エネルギー使用量、原材料使用量を削減する技術・プロセスの開発を進め、当社製品ライフサイクルにおいて環境負荷を低減する製品の開発・提供を推進



品質・サービスで顧客の
安定稼働・生産性に貢献

製造装置について、グローバルでレジリエントな供給・稼働を実現し続け、顧客の継続的発展が維持されている



事業に直結するマテリアリティへの取組みを進め、価値提供と利益創出の積み重ねにより
人々の豊かな暮らしの実現と企業価値向上を目指す

4つの柱④：マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進 ②

価値創出の基盤となるマテリアリティ

<p>気候変動への対応</p>	<p>CO2排出量削減 50% (2030年度までに2019年度比)</p>							
<p>環境負荷の低減</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物削減（再資源化率99%以上） ・環境調和型製品 売上高比85% 							
<p>多様な人財が活躍できる環境づくり</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・中核人財の登用における多様性確保 (2033年度までに女性管理職10%) 							
<p>サプライチェーンマネジメントの強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・信頼関係に根付いたパートナーシップと開かれた機会の提供 							
<p>ガバナンスの強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・取締役会の実効性の向上 ・積極的且つ能動的なサステナビリティ経営の推進 							

これまでのCSR活動をサステナビリティを巡る課題への対応として捉え直し、マテリアリティに落とし込んだ活動により中長期的な企業価値向上へ結び付く取組みへと発展させる

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END

Appendix

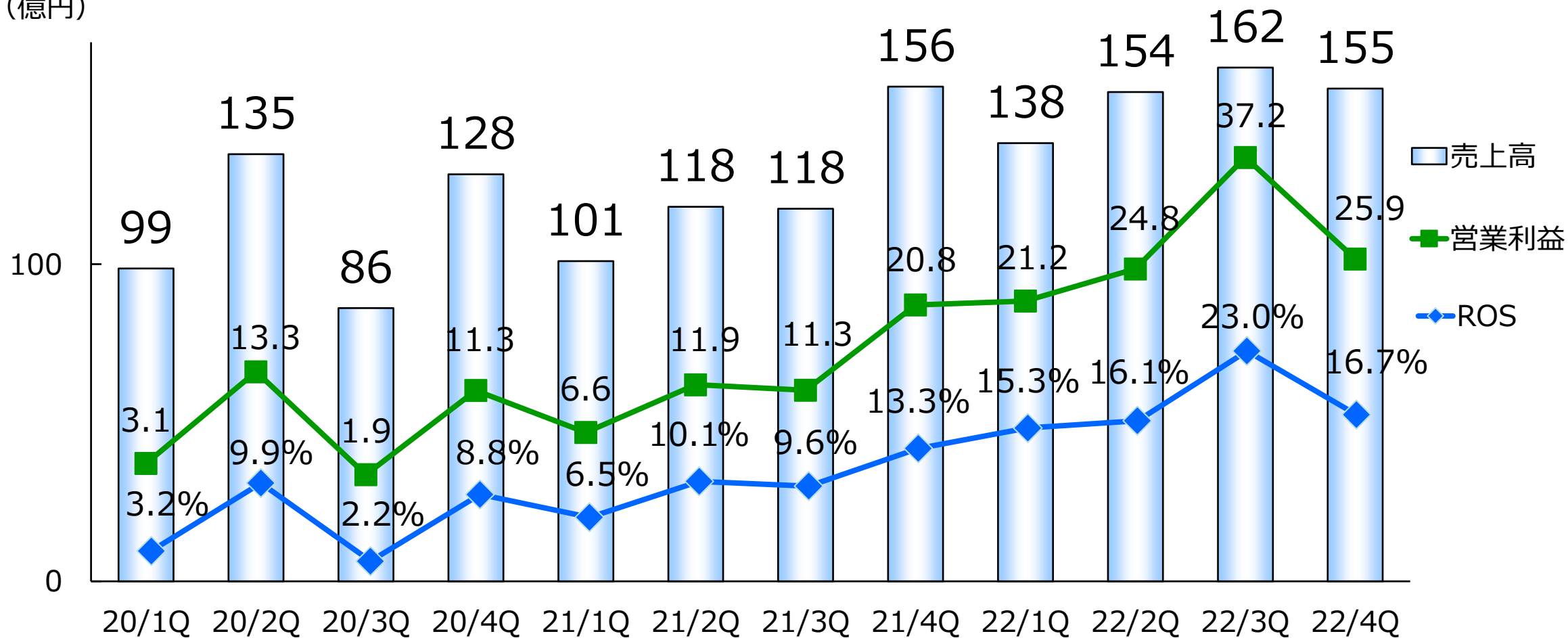
業績結果

(単位：億円)

	年度実績					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
売上高	493	531	471	448	493	610
営業利益	25.0	40.0	31.2	29.6	50.5	109.1
ROS	5.1%	7.5%	6.6%	6.6%	10.3%	17.9%
経常利益	23.5	37.8	27.7	28.2	48.8	105.1
当期純利益	17.5	24.8	19.4	19.7	29.8	92.0
ROE	10.7%	14.4%	10.2%	9.5%	12.8%	31.9%
配当	80円	140円	110円	110円	230円	560円

売上高・利益・ROS

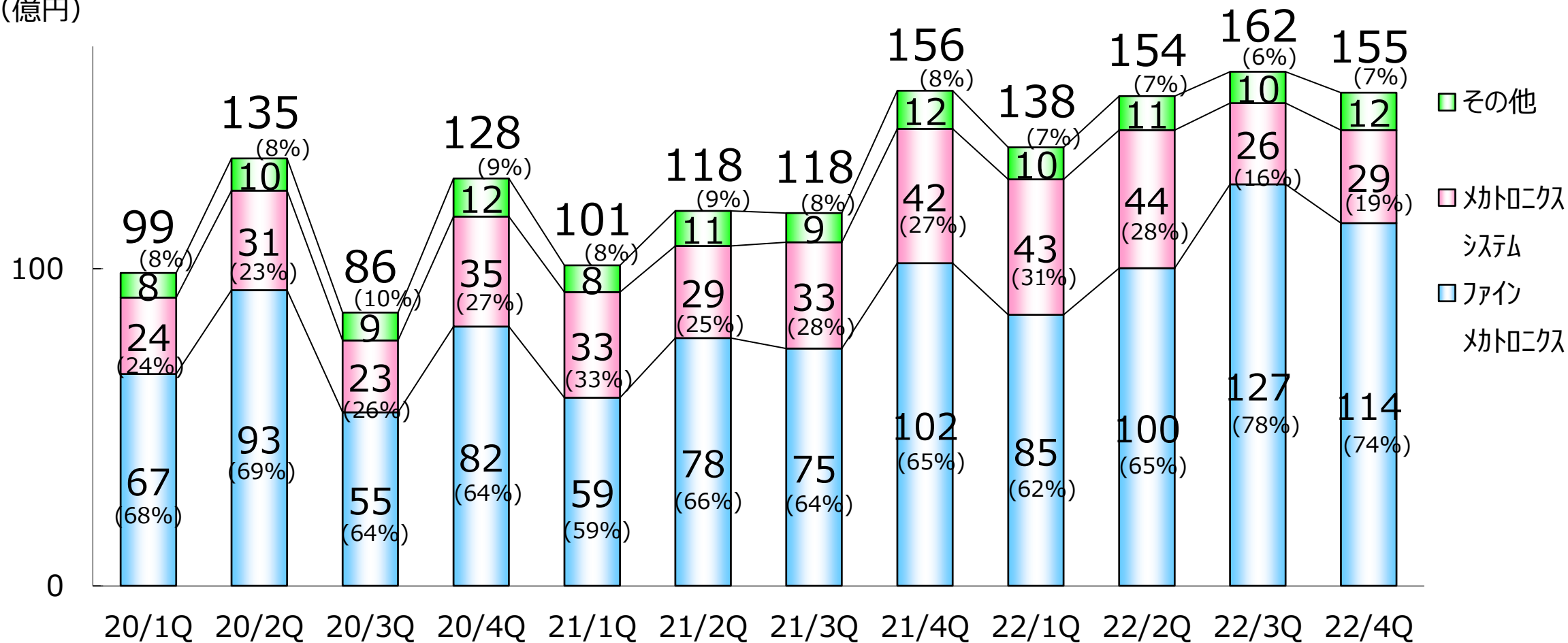
(億円)



セグメント別売上高

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

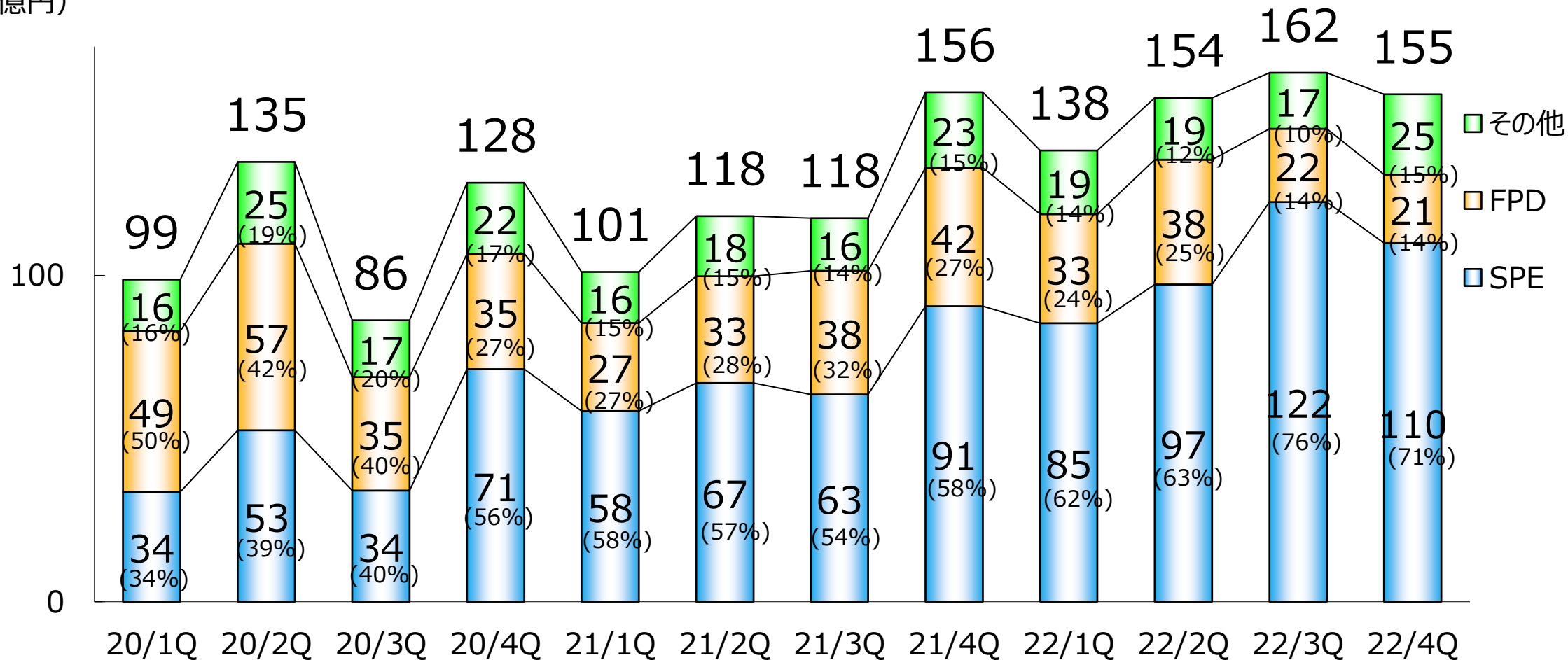
(億円)



分野別売上高

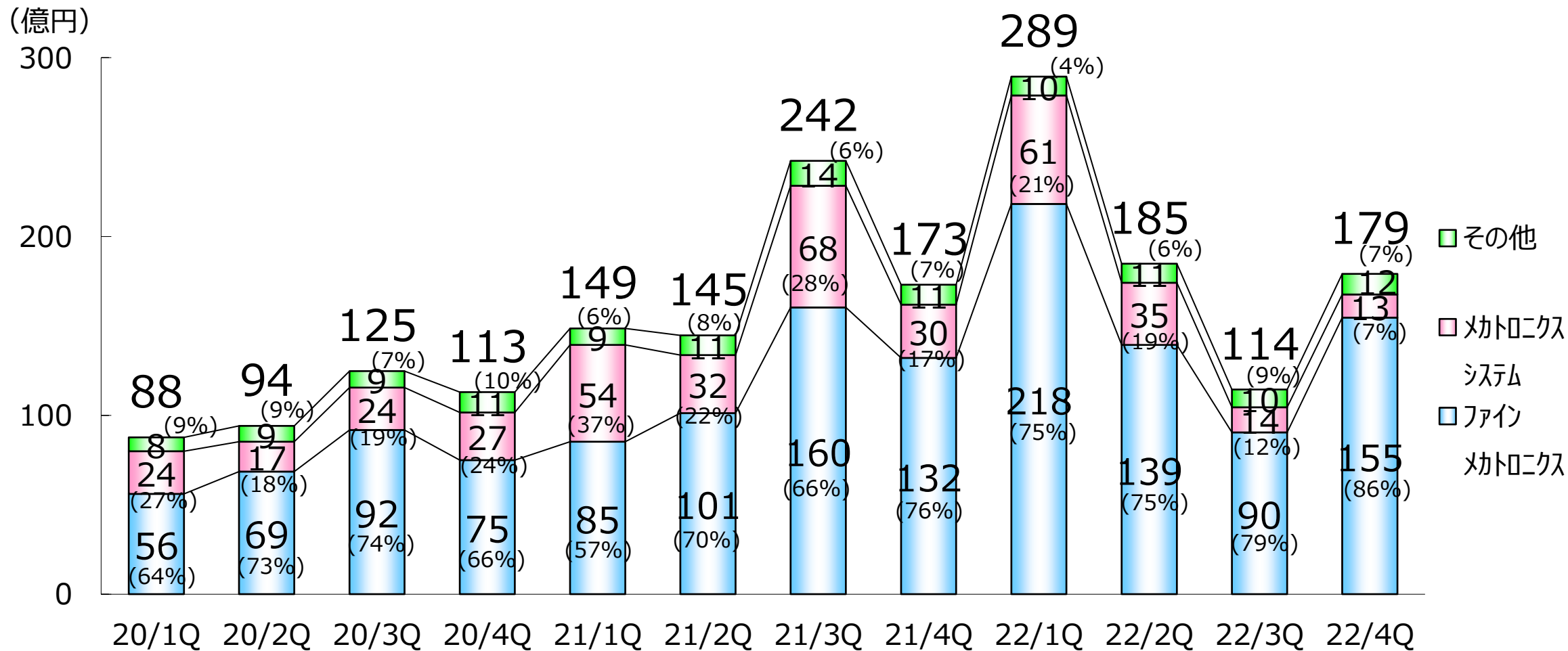
* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

(億円)



セグメント別受注高

* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置
メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

